STANDARD LAGENAUFBAU HDI

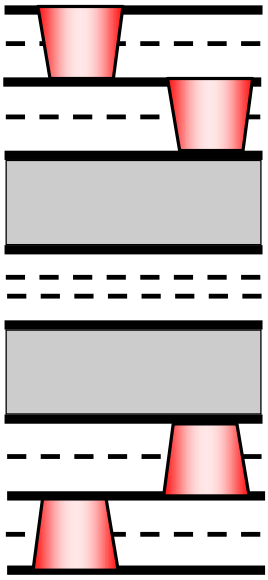
HDI08_2+4+2_1,40_35

8 - Lagen

Kerne: 0,41 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		2 + 4 + 2
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
3	2			35 µm		33	
			0,410 mm			410	
4	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
5	4			35 µm		33	
			0,410 mm			410	
6	5			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
7	RSK1		Folie	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

					Gesamtdicke Material:	1400	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,40**	+/-	0,11	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,49	+/-	0,14	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,55	+/-	0,16	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	9+